



Selección de complementos para módulos DRAM: Protecciones fiables para entornos hostiles

Los módulos DRAM están cada vez más presentes en entornos difíciles, en la mayoría de casos las altas temperaturas, vibraciones, contaminantes y productos químicos pueden provocar que nuestros equipos dejen de funcionar correctamente. Debido a estas problemáticas, existe una creciente demanda de mayor protección para evitar graves daños en los equipos electrónicos, como la corrosión, cortocircuitos, falsos contactos etc

Innodisk es un proveedor líder mundial de soluciones de memoria industrial. Proporcionamos módulos DRAM de alta calidad y ofrecemos una selección de complementos fiables para nuestros clientes, como barnizado, tecnología de sellado lateral, disipador de calor y clip resistente con el fin de garantizar la estabilidad y el rendimiento de las aplicaciones de los clientes

Barnizado

El barnizado es un método que resulta eficaz para proteger los módulos DRAM de la corrosión, los cortocircuitos, el desgaste y otros daños. La aplicación de una fina capa aislante de acrílico y silicona sobre el módulo puede ayudar a protegerlo de los contaminantes y aumentar su vida útil. Nuestro barnizado utiliza materiales de primera calidad suministrados por HumiSeal y cumple la norma de inspección IPC-A-610 con calidad y fiabilidad.

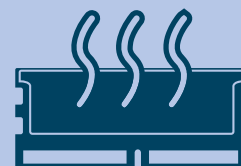


Tecnología de relleno lateral

La tecnología de sellado lateral puede contribuir a aumentar la solidez de la conexión entre el PCB y la BGA, mejorar la fiabilidad y prolongar la vida útil del producto cuando está sometido a fuertes sacudidas o ciclos térmicos extremos. La aplicación de resina en los tres lados del CI de la DRAM refuerza la unión entre la conexión BGA y el PCB. Las pruebas de tensión demuestran que, con el sellado lateral, los módulos toleran el doble de fuerza antes de poder desenchafarse de su ubicación.

Disipador de calor

El disipador de calor está diseñado específicamente para reducir el calor, ya que el CI BGA es cada vez más pequeño y favorece la generación de calor. Con la excelente radiación térmica y conducción del calor, el disipador de calor permite que los módulos DRAM funcionen a una temperatura adecuada y estable ayudando a disipar de forma pasiva el calor enfriando el módulo un 5 %. Disponemos de dos opciones de materiales (aluminio y nanotubos de carbono) que mejoran la disipación del calor acumulado.



Clip resistente

El clip resistente es un diseño altamente fiable que contribuye a evitar que los módulos DRAM se desprendan del zócalo de la PCB cuando están sometidos a sacudidas, vibraciones sostenidas y movimientos bruscos. Es un método flexible para estabilizar la memoria dentro de la ranura sin cambiar el diseño de las placas base. Nuestro clip resistente puede trabajar en estos entornos críticos, además está certificado bajo el estándar EIA 364-28 VII.



Sede

Innodisk Corporation

5F., No. 237, Sec. 1, Datong Rd., Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan (R.O.C.)
TEL : +886-2-7703-3000 FAX : +886-2-7703-3555
E-mail : sales@innodisk.com